

Express5800/R120h-2M(3rd-Gen) スペック詳細

2019/12/26初版

製品名称				Express5800/R120h-2M									
モデル名				8x 2.5型ドライブモデル		24x 2.5型ドライブモデル		8x3.5型ドライブモデル		12x3.5型ドライブ			
製品型名				N8100-2836Y		N8100-2837Y		N8100-2838Y		N8100-2839Y			
CPU	Processor	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3204(6C/6T, 1.90 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4208(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4210(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4214(12C/24T, 2.20 GHz, 16.5MB, TDP 85W), Silver 4215(8C/16T, 2.50 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4216(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 100W), Gold 5215(10C/20T, 2.50 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5217(8C/16T, 3 GHz, 11MB, TDP 115W), Gold 5218(16C/32T, 2.30 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 5220(18C/36T, 2.20 GHz, 24.75MB, TDP 125W), Gold 5222(4C/8T, 3.80 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6226(12C/24T, 2.70 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6230(20C/40T, 2.10 GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6234(8C/16T, 3.30 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6238(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240(18C/36T, 2.60 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6242(16C/32T, 2.80 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6244(8C/16T, 3.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6248(20C/40T, 2.50 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6252(24C/48T, 2.10 GHz, 35.75MB, TDP 150W), Gold 6254(18C/36T, 3.10 GHz, 24.75MB, TDP 200W), Platinum 8260(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8268(24C/48T, 2.90 GHz, 35.75MB, TDP 205W), Platinum 8280(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215M(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238M(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240M(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8260M(24C/48T, 2.40 GHz, 35.75MB, TDP 165W), Platinum 8280M(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W), Gold 5215L(10C/20T, 2.50GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 6238L(22C/44T, 2.10GHz, 30.25MB, TDP 140W), Gold 6240L(18C/36T, 2.60GHz, 24.75MB, TDP 150W), Platinum 8280L(28C/56T, 2.70 GHz, 38.50MB, TDP 205W)											
		標準搭載数 / 最大搭載数											
		コントローラ・ハブとの接続											
		インテル® 64											
		インテル® パーチャライゼーション・テクノロジー											
		インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー											
		インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー											
		CPUソケット形状											
		ホットプラグ											
		冷却方式											
		チップセット				ファンなしヒートシンク インテル® C621 チップセット							
メモリ		搭載容量 標準 / 最大		標準搭載なし(セレクトابلオプション) / Registered DIMM : 1.5TB (24x 64GB), Load Reduced DIMM : 3TB (24x 128GB) DC Persistent DIMM : 6TB(12x 512GB)									
		メモリスロット数		24									
		増設単位		1									
		搭載メモリ		DDR4-2933 Registered DIMM (8/16/32/64GB), DDR4-2933 Load Reduced DIMM (128GB) DDR2-2666 DC Persistent DIMM(128/256/512)GB									
		最大動作周波数		2933MHz (CPU毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)									
		メモリバス帯域(/チャネルあたり)		23.4GB/s									
		メモリアクセス方式		インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法/BIOS設定に応じて12wayインターリーブをサポート)									
		誤り検出・訂正		ECC, x4 SDDC									
		メモリスベアリング		対応									
		メモリモラーリング		対応									
		ホットプラグ											
		モジュールピン数		288 ピン									
		動作電圧		1.2V									
		バッファ機能		対応									
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵スロット	フロント	8x2.5型ドライブ 8x2.5型増設ドライブ(オプション 最大1個)		24x2.5型ドライブ		8x3.5型ドライブ		12x3.5型ドライブ			
			リア	2x 2.5型ドライブ(オプション 最大3個), 3x 3.5型ドライブ(オプション 最大1個)									
		内蔵標準	2x M.2 SATAスロット										
		内蔵最大	2.5型HDD: SATA 48TB (24x 2TB), SAS 57.6TB (24x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 92.16TB (24x 3.84TB), SAS SSD : 46.08TB (24x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		2.5型HDD: SATA 60TB (30x 2TB), SAS 72TB (30x 2.4TB) 2.5型SSD: SATA 115.2TB (30x 3.84TB), SAS SSD : 57.6TB (30x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 180TB(15x 12TB),ニアライン SAS 180TB(15x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 8TB (4x 2TB), SAS 9.6TB(4x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 15.36TB(4x 3.84TB), SAS SSD : 7.68TB (4x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)		3.5型HDD : SATA 228TB(19x 12TB),ニアライン SAS 228TB(19x 12TB) + 2.5型HDD: SATA 4TB (2x 2TB), SAS 4.8TB(2x 2.4TB), 2.5型SSD: SATA 7.68TB(2x 3.84TB), SAS SSD : 3.84TB (2x1.92TB) (オプションHDDケージ追加時)				
			ホットスワップ	対応									
		インタフェース規格とRAID構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)									
		光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1									
		FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB) *2									
		拡張ベイ											
		拡張スロット	対応スロット	標準構成 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, フルレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) (フルハイト, フルレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト, ハーフレンジス) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (LOMカード専用) (オプションのライザカードを手配することでPCI構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)									
規格													
PCI Express 1.1, 2.0, 3.0													
グラフィックス		搭載チップ / ビデオRAM グラフィック表示 と 解像度		マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200									
標準インタフェース	フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用), 2xUSB2.0(Type A)(オプション) *12		1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用)		1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC用)		-					
		リア		2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン), 1x マネージメント専用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45) 1x シリアルポート (オプション) 2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0 LOM (必須選択オプション) 1x Intel I350 or 1x Intel X550									
ネットワーク	実装形式	2x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 3.0											
	コントローラ	LOM (必須選択オプション)											
	チームング	1x Intel I350 or 1x Intel X550											
	FEC / GEC	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)											
	ジャンプフューム	対応											
リモートマネージメント	PXE / iSCSI ブート	対応 (Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)											
	コントローラ	PXEブート: 対応, iSCSIブート: 非対応											
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)		BMC											
キーボード / マウス		Marvell PHY											
BIOS Version (出荷当初)		対応											
BMC Firmware Revision (出荷当初)		オプション											
System Sleep State		System ROM U30 v2.16 (最新のバージョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)											
冗長電源		1.47 (最新のリビジョンはサポート情報のダウンロードサイトでご確認ください)											
冗長ファン		S0, S5											
筐体デザイン		対応 (オプション, ホットプラグ可)											
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)		対応 (標準, ホットプラグ可)											
質量 (最小/ 最大)		1Uラックマウント											
電源		445.5mm x 679.4mm x 87.3mm (2.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず) 445.5mm x 730.2mm x 87.3mm (3.5型ドライブモデル : フロントベゼル/レール/突起物含まず)											
		15kg / 39kg		15kg / 39kg		15kg / 45kg		15kg / 46kg					
		選択必須オプション AC電源ユニット(N8181-160) 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) AC電源ユニット(N8181-161, 162) 800W 80 PLUS® Titanium/1600W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) DC電源ユニット(N8181-163) 800W DC-48V電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) (電源ケーブルは必須選択オプション) *10 908VA / 899W (800W電源最大値)											
		消費電力(100V最大構成時, 最大電力)											
		消費電力(200V最大構成時, 最大電力)											
		発熱量											
		省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率											
音量	音圧レベル (待機時 / 高負荷時) *4	対象外											
		34dBA / 34dBA											
測定方式		ISO7779基準, 傍観者位置測定 (床: 1.5m, サーバとの距離: 1m), サーバ設置(床: 0.75m), 環境温度23℃ 動作時: 10~35℃(条件付きで5~40℃/45℃対応可) *11, 保管時: -30~60℃ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)											
ハードウェア認証規定		VCCI クラス A											
OS認証		Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware											
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル											
無償保証内容		3年オンサイト保守サービス(月~金, 9:00~18:00, 原則翌営業日対応, 国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)											
インストールOS		3年パーツ保証											
サポートOS	NECサポート	-											
		Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2019 Standard, Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter, VMware ESXi™ 6.5 Update2, VMware ESXi™ 6.7 Update2 最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います											
動作確認OS *6													

**注意事項**  
拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまで を示します

注釈

- \*1 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIを全システムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVD-ROMをシステムで最低1式は必ず手配してください。
- \*2 必要に応じて手配してください。主な用途については、システム構成ガイド「Flash FDD製品概要と利用ケース」を参照下さい。
- \*4 特定構成(2xCPU(Xeon Silver 4114), 2x16GB DIMM, 1xRAIDコントローラ, 標準ファン, 1x500W電源)での騒音値
- \*6 BTOインストール不可。NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux On Express5800」を参照願います。
- \*7 CPU TDPごとの最大電力は、システム構成ガイド「9.1.2 CPU TDPごとの最大電力」をご参照ください。
- \*10 DC-48V電源のほかDC380V電源を本装置で活用されたい方は、弊社営業まで別途お問い合わせください。
- \*11 40℃/45℃環境においてそれぞれ構成制限及び環境制限があります。詳細は「リファレンス」の「40℃/45℃対応についての注意事項」をご参照ください。